

华润微电子有限公司

投资者关系活动记录表

(2026 年 4 月)

证券简称：华润微

证券代码：688396

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☒路演活动 ☒现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）		
参与单位名称	04 月 24 日 国信证券 广发证券 东方财富证券 摩根大通证券 国泰海通证券 财通证券 招商证券 太平洋证券 国金证券 中信证券 光大证券 凯基证券 宝盈基金 淡水泉投资 东兴基金 泓德基金 财信基金 中铝资本 中国国际金融 中信建投证券 华福证券 浙商证券 东方证券 瑞银证券 西部证券 上海证券 天风证券 泰康保险 华创证券 财通基金 长盛基金 华安基金 嘉实基金 北京涇谷私募 杭州玖龙资产 海南羊角私募 国联民生证券 国海证券 华源证券 东海证券 兴业证券 美银证券 长城证券 国元证券 花旗環球金融 东方证券资产管理 摩根士丹利资本 中国太平洋保险 吕梁小金地资产 申万菱信基金 中信保诚基金 西部利得基金 交银施罗德基金 复星保德信人寿		

	上海呈瑞投资 汇瑾股权投资 北京致顺投资 上海汇瑾投资 上海道仁资产 山东嘉信私募 广东钜洲投资 曼林私募 上海嘉世私募 麦格理资本 泉果基金 富国基金 合众资产管理 中信期货 上海赤祺资产 埃普斯国际 上海润桂投资 北京沸点私募 上海匀升投资 三鑫资产 中军投资 红石榴私募 景瑞私募 鸿运私募 盛钧私募 厦门观升私募 天惠投资 尚诚资产管理 国信中数私募 玄卜投资 天阔私募 上海博笃投资 上海世亨私募 国富联合私募 麻王投资 上海元昊投资 上海景林资产 沃虎基金 中国人寿养老保险 野村投资管理 杭州深沃投资 重庆市金科投资 上海瞰道资产 上海云门投资 广州市航长投资 上海合道资产 苏州龙远投资 上海汇正研究所 上海度势投资 江岳私募 联创永圆股权投资 前海诚域私募 西安瀑布资产 前海汇杰达理资本 深圳市兴亿投资 XL Equities IGWT Investment 04 月 28 日 广发证券、国联民生证券、中泰证券、中邮证券、东方红投资、银华基金、盘京投资、博时基金、平安资产、泰康基金、大成基金、华商基金、中国人民养老保险、光大保德信基金、兴全基金、兴业基金、兴银基金、德邦基金、农银汇理基金、利幄基金、华安基金、华泰保兴基金、国投瑞银基金、国泰基金、国联基金、国金基金、富国基金、太平基金、朱雀基金、富安达基金、浦银安盛基金、银河基金、长信基金、长安基金、银叶投资
时间	04 月 24 日 、04 月 28 日
地点	无锡、上海

上市公司接待人员姓名	何小龙 华润微电子董事长 吴国屹 华润微电子董事、财务总监兼董秘 沈筛英 华润微电子董事会办公室主任
投资者关系活动主要内容介绍	问题一：请问公司如何判断本轮功率半导体行业景气的持续性？ 答：公司认为，本轮行业复苏主要由 AI 需求驱动。AI 既带来可观的增量应用需求，也对部分非 AI 领域的产能供给形成挤出效应。公司预计 2026 年全年产能利用率有望维持在较高水平。 问题二：请问公司后续产能增长的规划情况？ 答：公司后续产能扩充将聚焦两大方向：一是加大第三代半导体项目的投入力度。二是推进 12 吋产线扩建，其中重庆 12 吋项目计划于年内追加投资，进一步扩大规模效应；深圳 12 吋项目在实现满产目标后，将利用现有厂房空间进行适度扩产评估。同时，公司也会结合产线运营及市场变化，“十五五”期间适时启动新产能建设。 问题三：在当前产能满载的情况下，公司今年的资本开支预期是多少？ 答：公司 2026 年资本性开支预计 20 亿元左右，该金额仅涵盖固定资产投资。另外 40 亿元预算将用于对外收购兼并等股权投资类资本性开支，具体实施将视标的情况审慎推进。 问题四：请问公司在新兴领域的业务进展情况？ 答：AI 相关应用整体需求旺盛，公司在服务器电源、低空经济、机器人等新兴领域已实现批量出货。其中，以无人机为代表的高潜力应用领域增量最为显著，2026 年预期实现高速增长。

问题五：公司在 AI 服务器电源领域的布局及单台价值量如何？

答：公司围绕 DrMOS 功率模块、多相电源控制器、板级 POL、硅基及第三代半导体驱动及控制芯片构建产品矩阵，覆盖一级电源（PSU/HVDC/SST）、二级 IBC、三级板级电源（POL）等领域，提供功率器件、驱动、控制及模块一体化方案。目前 SGT MOS、SJ MOS、SiC、GaN、IGBT 等产品已稳定供应头部云厂商、服务器 OEM 及电源制造商，多个重点项目正稳步推进。全系列产品配套完成后，单台服务器中公司产品价值量预计可占电源方案总成本的 30% - 60%。

问题六：请问公司先进封装是否会和光模块结合？

答：公司 PLP 封装可通过缩小封装尺寸提升散热能力，满足光模块应用对尺寸和散热的严格要求。公司利用 PLP 工艺优势，开发 PoP 高密度堆叠封装技术切入 AI 电源赛道，同时与光模块领域头部客户合作开发新一代光模块电源驱动模块，预计于 2026 年下半年实现量产。

问题七：公司如何展望毛利率的变化趋势？

答：作为重资产公司，持续性的资本投入与产能迭代是保持长远竞争力的必然选择，折旧与摊销在未来一段时期内仍是影响毛利率的重要因素。当前公司的首要目标是通过持续优化产品与客户结构，逐步推动毛利率向上修复。

问题八：公司目前多个大型项目逐步爬坡达产，请问公司当前经营利润的具体表现及未来展望？

答：公司在“十四五”期间投资建设了两条 12 吋产线、先进封装基地及高端掩模项目。其中，两条 12 吋产线未纳入公司合并报表范围的主体运营，其折旧不计入上市公司合并报表，但仍需按持

	股比例以权益法确认投资损益，因此该部分损益现阶段受相关单体报表亏损影响。剔除如上影响后，公司主营业务表现稳健。近年来公司经营利润稳定在 10 亿元以上，2026 年目标实现进一步增长，整体经营利润呈向好趋势。 问题九：深圳 12 吋项目爬坡进度和预期？是否有二期规划？ 答：深圳 12 吋项目已建成 1.5 万片/月产能，计划于 2026 年底实现产能建设超 3 万片/月，并力争于 2027 年上半年完成规划产能并实现满载。一期达产后，公司将优先评估利用现有厂房空间进行扩产的可能性；二期项目将在一期运营稳定后适时启动。 问题十：请问在“十五五”规划中，功率半导体、化合物半导体、传感器这三条增长曲线的具体规划及资源投入方向是什么？ 答：第一增长曲线是硅基功率产品及制造服务。重点以硅基功率器件、功率 IC 和特色制造服务为基础，提升产品模块化和方案化能力，巩固传统市场，扩大高端份额。 第二增长曲线是第三代半导体。重点拓展新能源汽车、数据中心及通讯设备等高频、高压、高端应用场景，通过构建技术壁垒和释放规模效应，形成批量竞争优势。 第三增长曲线是传感器及光芯片。重点布局 MEMS、视觉及光芯片等核心产品，切入通信、机器人、智能驾驶及边缘计算场景，拓展新增长空间。 公司将依托上述三条增长曲线，结合内涵增长与外延并购实现“十五五”战略目标，资源投入将结合具体项目推进。公司现金流充裕、融资渠道畅通，将优先聚焦第三代半导体与智能传感器等优质赛道，并对高端芯片、AI 算力相关领域保持前瞻性布局。
附件清单（如有）	无

日期	2026 年 4 月
----	------------